

檔 號：0114/050406
保存年限：5年

國家科學及技術委員會 函

地 址：臺北市大安區和平東路二段106號
傳 真：02-2737-7619
承 辦 人：陳家漪
聯絡電話：02-2737-7932
電子郵件：cchen22@nstc.gov.tw

受 文 者：開南大學

發文日期：中華民國 114 年 6 月 4 日

發文字號：科會產字第1140037188號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附 件：共(2)件 如文(共 2 個附件：
fd78f2bd5da2592e920bd92a63786495_114T0P002285_114D2015471-01.pdf、
fd78f2bd5da2592e920bd92a63786495_114T0P002285_114D2015472-01.pdf)
fd78f2bd5da2592e920bd92a63786495_114T0P002285_114D2015471-01.pdf (附件1)
fd78f2bd5da2592e920bd92a63786495_114T0P002285_114D2015472-01.pdf (附件2)

主旨：檢送本會辦理IC Taiwan Grand Challenge全球徵案競賽資訊，惠請查照轉知，並鼓勵踴躍參加。

說明：

- 一、本會辦理IC Taiwan Grand Challenge全球徵案競賽，即日起開放報名至114年6月30日止，鼓勵創新者運用AI晶片、AI演算法、高速傳輸等開發以下類別之先進應用解決方案，或就核心技術進行突破創新：AI Core Technologies and Chips、Smart Mobility、Smart Manufacturing、Smart Medtech、Sustainability，誠摯邀請貴單位及相關國際合作研究機構報名參加。
- 二、本競賽對象包含欲攜手臺灣半導體晶片設計、製造產業，共同合作發展創新應用之新創、法人及學研機構、自然人，每隊獲獎團隊將獲得落地獎金、展會展出、IC新創加速平台產業鏈結及在臺晶片發展輔導等資源。
- 三、檢附本案競賽宣傳文宣，詳情請上活動官網查詢<https://ictaiwanchallenge.org/>，或洽聯繫窗

口：執行單位台北市電腦公會陳先生(02)2577-4249 #940。

正本：專題研究計畫受補助單位（共297單位）
副本：

主任委員吳誠文

決行層次：建請 層決行